

随意契約に関する事前確認公募

公募期間:令和 7 年 9 月 2 日(火)～令和 7 年 9 月 11 日(木)

本学は、以下に示す案件について、下記Ⅲ.に示す条件を満たす特定の者と随意契約を予定しております。このため、調達可能な者の有無を事前確認するための公募を行います。公募の結果、応募があり、下記Ⅲ.に示す条件を満たすと判断された場合は、企画競争又は一般競争入札等の手続きに移行します。

I. 随意契約予定事項

1. 件名
多層超伝導集積回路チップの製作(ADP670)
2. 業務の目的
高速低消費エネルギー動作を特徴とする多層ニオブ金属を用いた超伝導集積回路のチップ試作を行う。
3. 業務の概要
 - ① 納入期限:令和 8 年 1 月 30 日
 - ② 納入場所:国立大学法人横浜国立大学 電子情報工学棟 107 室
 - ③ 業務内容:極低温動作作用の多層ニオブ金属を用いた超伝導集積回路のチップ試作
※詳細については、別紙【仕様書】を参照。

II. 公募に参加する者に必要な資格に関する事項

- ① 国立大学法人横浜国立大学契約実施規則第 4 条及び第 5 条の規定に該当しない者であること。
- ② 国立大学法人横浜国立大学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- ③ 「調達に関する国立大学法人横浜国立大学の基本方針」を遵守する旨の誓約書を提出している者であること。

III. 特殊な技術及び設備の条件

・Nb/AlOx/Nb Josephson 接合作成装置、超伝導体薄膜作成装置、絶縁体薄膜成膜装置、フォトリソグラフィー装置、エッチング装置、CMP 装置を有しており、多層ニオブ金属を用いた超伝導集積回路の製作を行えること。

IV. 公募の条件を満たす旨の意思表示

本公募の条件を満たしており、参加を希望する者は、【参加意思表示書】(様式は別添)を提出すること。

提出期限:令和 7 年 9 月 12 日(金)12:00 必着

提出先:下記Ⅴ.のとおり

提出方法:持参、郵送、または E-mail によること。各提出方法詳細は次のとおり。

・持 参 受付時間:平日 8 時 30 分～17 時 15 分(12 時 00 分～13 時 00 分を除く)。

※土・日・祝日を除く。

- ・郵 送 簡易書留や宅配便等の配達記録が残るものにする。
- ・E-mail 開封確認要求により送信を行い、本学担当者の開封連絡を必ず確認すること。一定時間が経っても開封連絡が届かない場合は、電話等により受信を確認すること。なお、誤送信やサーバー不調等の原因如何に係らず、期間内に本学担当に届いていない場合は、提出が無かったものとして取り扱う。

様 式: 本学指定の別添【参加意思表明書】による。

そ の 他: 本公募への参加を検討するために詳細情報を希望するものは、下記 V. に記載の本件担当宛連絡すること。なお、この場合でも、参加を希望する場合は、提出期限までに参加意思表明書の提出が必要である。

V. 本件担当(提出・問い合わせ先)

住 所: 〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1

担 当: 国立大学法人横浜国立大学 財務部 経理課 契約第一係

T E L: 045-339-3241 / 3242

E-mail: keiri.keiyaku1@ynu.ac.jp